

住友ベークライト株式会社 2024年3月期第2四半期 決算説明会
主な質疑応答議事録

日時：2023年11月6日(月) 15時00分～16時30分

説明者：代表取締役社長執行役員 藤原 一彦

質疑応答では各部門担当役員による補足説明あり

【全社的な事項】

Q：本中期計画の事業利益 300 億円には未達の予想であるが、想定と異なったのは何か？

A：半導体市場の失速と回復の遅れ、半導体不足による自動車減産の影響が挙げられる。

Q：キャッシュアロケーションの考え方について教えて欲しい。

A：株主還元を増やす方策は状況に応じて検討していく。また、設備投資や M&A、DX やカーボンニュートラル等サステナビリティ推進のための投資などの資金需要を見込んでいく。

【半導体関連材料セグメント】

Q：半導体封止材の伸び率とアプリケーション別の状況について教えて欲しい。

A：半導体封止材の数量は前年上期比でほぼ横ばいであった。アプリケーション別には、民生は低調であったが、車載半導体とモビリティ戦略3製品は堅調であった。

Q：半導体封止材の下期の見通しを教えて欲しい。

A：上期と比較して景況感は横ばいであるが、中華圏の大型連休等の季節要因による数量減を見込んでいる。

Q：モビリティ戦略3製品の今期計画を上方修正したが、何が牽引したのか？

A：3製品ともに順調に伸長している。

【高機能プラスチックセグメント】

Q：下期の回復の背景について教えて欲しい。

A：家電等民生製品の滞留在庫が解消されつつある。航空機用内装品も緩やかに回復が進んでいる。

【クオリティオブライフ関連製品】

Q：業績予想の下方修正の背景について

A：半導体製造工程等で使われる産業用途のフィルム・シートが、顧客の在庫調整により回復が遅れている。産業機能性材料においては、汎用建材用途が低調であった。

以上